



Initial Product/Process Change Notification

Document #:IPCN23868XC

Issue Date:09 Jul 2021

Title of Change:	WLCSP Manufacturing site transfer from ON Semiconductor Niigata to ASE ChungLi
Proposed First Ship date:	30 Apr 2022 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Hiroto.Yamada@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Date Code
Change Category:	Assembly Change
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Transfer

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
None	ASECL, Taiwan (ChungLi)

Description and Purpose:

Due to sale of Niigata factory announcement on Aug 8, 2020, ON Semiconductor has issued this IPCN of WLCSP Site Change on the affected parts.

	Before Change Description	After Change Description
WLCSP Assembly Site	ON Semiconductor Niigata	Advanced Semiconductor Engineering Inc., ChungLi

This Change is distinguished by date code of the top marking below.

	Affected OPN	From	To
Product marking change	LC709204FXE-01TBG LC709204VXE-01TBG	Line1: 20401 Line2: AWLYW (A: Assembly site = Z)	Line1: 20401 Line2: AWLYW (A: Assembly site = h)
Product marking change	LC709205FXE-01TBG	Line1: 20501 Line2: AWLYW (A: Assembly site = Z)	Line1: 20501 Line2: AWLYW (A: Assembly site = h)

There is no impact except the above.

**Qualification Plan:****QV DEVICE NAME:** LC6WF9T40A-3A70-TBG**RMS #:** 076563**PACKAGE:** WLCSP179, 5.00x7.27x0.60

Test	Specification	Condition	Interval
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	500 cyc
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH, 17.7 psig, bias	264 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-

QV DEVICE NAME: LC898249AXHTBG**RMS #:** 076970**PACKAGE:** WLCSP6, 0.86x1.75x0.265

Test	Specification	Condition	Interval
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	500 cyc
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-

Estimated date for qualification completion: 27 November 2021

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
LC709205FXE-01TBG	LC6WF9T40A-3A70-TBG
LC709204VXE-01TBG	LC6WF9T40A-3A70-TBG
LC709204FXE-01TBG	LC6WF9T40A-3A70-TBG

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23868XC

発行日: 09 Jul 2021

変更件名:	オン・セミコンダクター新潟から ASE ChungLi へ WLCSP 製造拠点の移管		
初回出荷予定日:	2022 年 4 月 30 日またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前		
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Hiroto.Yamada@onsemi.com> にお問い合わせください。		
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回 PCN または最終 PCN の最初の通知の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。		
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だてて通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。		
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	デートコード		
変更カテゴリ:	組立の変更		
変更サブカテゴリ:	製造拠点の移管		
影響を受ける拠点:			
オン・セミコンダクター拠点:	なし	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
		ASECL, Taiwan (ChungLi)	
説明および目的:	2020 年 8 月 8 日の新潟工場売却の発表に伴い、オン・セミコンダクターは、影響を受ける部品の WLCSP 製造拠点の変更を本 IPCN により通知いたします。		
	変更前の表記	変更後の表記	
WLCSP 組み立て拠点	ON Semiconductor Niigata	Advanced Semiconductor Engineering Inc., ChungLi	
この変更は、下記のように、トップマーキングのデートコードにより識別されます。			
	影響を受ける OPN	変更前	変更後
製品表示変更	LC709204FXE-01TBG LC709204VXE-01TBG	Line1: 20401 Line2: AWLYW (A: Assembly site = Z)	Line1: 20401 Line2: AWLYW (A: Assembly site = h)
製品表示変更	LC709205FXE-01TBG	Line1: 20501 Line2: AWLYW (A: Assembly site = Z)	Line1: 20501 Line2: AWLYW (A: Assembly site = h)
上記以外の影響はありません。			



認定計画:

デバイス名: LC6WF9T40A-3A70-TBGRMS: O76563パッケージ: WLCSP179, 5.00x7.27x0.60

テスト	規格	条件	間隔
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	500 cyc
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH, 17.7 psig, bias	264 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-

デバイス名: LC898249AXHTBGRMS: O76970パッケージ: WLCSP6, 0.86x1.75x0.265

テスト	規格	条件	間隔
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	500 cyc
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-

認定完了予定日: 27 November 2021

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
LC709205FXE-01TBG	LC6WF9T40A-3A70-TBG
LC709204VXE-01TBG	LC6WF9T40A-3A70-TBG
LC709204FXE-01TBG	LC6WF9T40A-3A70-TBG